

DCB N	EFINITION
Layer count :	2
Board thickness :	1,6mm
Board material :	FR4
Surface :	Copper 35um + NiAu
Minimum track width :	>= 0.15mm
Minimum copper gaps :	
Minimum drill diameter :	
Solder mask color :	
Silkscreen color :	
GERBE Layer1 Top :	ER FILES X
Layer 2 Bottom :	Х
Layer 3:	
Layer4 :	-
Solder Mask Top :	X
Solder Mask Bottom :	Х
Silkscreen Top :	_
Silkscreen Bottom :	-
Drill drawing :	Х
Drill excellon :	Х
Paste mask top :	Х
Paste mask bottom :	-
Assembly Top :	X
Assembly Bottom :	_

Désignation : Opto V01 Validation : B. Chiron 12/02/2016 ASSEMBLY : TOP



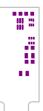
PCB DEFINITION		
Layer count :	2	
Board thickness :	1,6mm	
Board material :	FR4	
Surface :	Copper 35um + NiAu	
Minimum track width :	>= 0.15mm	
Minimum copper gaps :	>= 0.15mm	
Minimum drill diameter :		
Solder mask color :	Green	
Silkscreen color :		
Layer1 Top :	Х	
GERBE	R FILES	
Layer 2 Bottom :	Χ	
Layer 3 :	-	
Layer4 :		
Solder Mask Top :	X	
Solder Mask Bottom :	Χ	
Silkscreen Top :		
Silkscreen Bottom :	_	
Drill drawing :	Х	
Drill excellon :	X	
Paste mask top :	Х	
Paste mask bottom :		
Assembly Top :	X	
Assembly Bottom :	_	

Désignation : Opto V01 Validation : B. Chiron 12/02/2016 LAYER 1 : TOP



	EFINITION
Layer count :	2
Board thickness :	1,6mm
Board material :	FR4
Surface :	Copper 35um + NiAu
Minimum track width :	
Minimum copper gaps :	>= 0.15mm
Minimum drill diameter :	>= 0.3mm
Solder mask color :	Green
Silkscreen color :	
Layer1 Top :	Х
	R FILES
Layer 2 Bottom :	X
Layer 3 :	-
Layer4 :	_
Solder Mask Top :	X
Solder Mask Bottom :	Х
Silkscreen Top :	
Silkscreen Bottom :	-
Drill drawing :	Χ
Drill excellon :	Х
Paste mask top :	Х
Paste mask bottom :	
Assembly Top :	X
Assembly Bottom :	_

Désignation : Opto V01 Validation : B. Chiron 12/02/2016 LAYER 2 : BOTTOM



PCB DE	EFINITION
Layer count :	2
Board thickness :	1,6mm
Board material :	FR4
Surface :	Copper 35um + NiAu
Minimum track width :	>= 0.15mm
Minimum copper gaps :	>= 0.15mm
Minimum drill diameter :	
Solder mask color :	Green
Silkscreen color :	
Layer1 Top :	Х
	R FILES
Layer 2 Bottom :	X
Layer 3:	-
Layer4 :	-
Solder Mask Top :	Χ
Solder Mask Bottom :	Х
Silkscreen Top :	_
Silkscreen Bottom :	-
Drill drawing :	Х
Drill excellon :	Х
Paste mask top :	Х
Paste mask bottom :	
Assembly Top :	Х
Assembly Bottom :	



PCB DEFINITION		
Layer count :	2	
Board thickness :	1,6mm	
Board material :	FR4	
Surface :	Copper 35um + NiAu	
Minimum track width :	>= 0.15mm	
Minimum copper gaps :	>= 0.15mm	
Minimum drill diameter :		
Solder mask color :	Green	
Silkscreen color :		
Layer1 Top :	Х	
GERBE	R FILES	
Layer 2 Bottom :	Χ	
Layer 3 :	-	
Layer4 :		
Solder Mask Top :	X	
Solder Mask Bottom :	Χ	
Silkscreen Top :		
Silkscreen Bottom :	_	
Drill drawing :	Х	
Drill excellon :	X	
Paste mask top :	Х	
Paste mask bottom :		
Assembly Top :	X	
Assembly Bottom :	_	

Désignation : Opto V01 Validation : B. Chiron 12/02/2016 Solder Mask Top

PCB DEFINITION		
Layer count :	2	
Board thickness :	1,6mm	
Board material :	FR4	
Surface :	Copper 35um + NiAu	
Minimum track width :	>= 0.15mm	
Minimum copper gaps :	>= 0.15mm	
Minimum drill diameter :		
Solder mask color :	Green	
Silkscreen color :		
GERBER FILES Layer1 Top: X		
Layer 2 Bottom :	X	
Layer 3:		
Layer 4 :		
Solder Mask Top :	X	
Solder Mask Bottom :	X	
Silkscreen Top :	_	
Silkscreen Bottom :	_	
Drill drawing :	χ	
Drill excellon :	X	
Paste mask top :	X	
Paste mask bottom :	_	
Assembly Top :	X	
Assembly Bottom :	-	

Désignation : Opto V01
Validation : B. Chiron 12/02/2016
SOLDER MASK BOTTOM